

PCB 焊接工艺要求	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	交流伺服	ISED-F30FX 焊接要求	V5	1	2021-9-22
<p>1. 参照“ISED-F30FX_V5 内部焊接丝印图 PDF”文件；</p> <p>2. 红色序号的元件有焊接高度要求</p> <p style="padding-left: 20px;">D5、D14 的管脚高出线路板 8mm 整，并要横平竖直；</p> <p style="padding-left: 20px;">Q2、S1 的管脚高出线路板 7mm 整，并要横平竖直；</p> <p style="padding-left: 20px;">R157、R189、R190 圆体底部高出线路板 2~3mm；</p> <p>3. FX = F1 时，粉色框内的元件不焊接；</p> <p>4. FX = F2 时，蓝色框内的元件不焊接；</p> <p>5. 打叉的元件，不焊接；</p> <p>6. 未标注的元件，紧贴线路板焊接；</p> <p>7. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准</p>					
编制		审核		批准	
日期		日期		日期	